MARKET NEWS

Neue Leistungsmodule von Infineon mit hoher Stromdichte ermöglichen leistungsstarkes KI-Computing

München, 9. Oktober 2024 – Rechenzentren sind derzeit für mehr als zwei Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Dieser Anteil wird bis 2030 je nach Szenario auf etwa sieben Prozent ansteigen, was dem aktuellen Energieverbrauch Indiens entspricht. Eine effiziente Energieumwandlung vom Stromnetz zum Prozessor ist unerlässlich, um eine höhere Leistungsdichte zu ermöglichen und dadurch die Rechenleistung zu steigern sowie gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken. Die Infineon Technologies AG bringt daher die zweiphasigen Leistungsmodule TDM2354xD und TDM2354xT für hochleistungsfähige KI-Rechenzentren auf den Markt. Die Module verfügen über eine ausgezeichnete Leistungsdichte, ermöglichen echte Vertical Power Delivery (VPD) und bieten eine hervorragende Stromdichte von 1,6 A/mm². Sie folgen den zweiphasigen TDM2254xD-Leistungsmodulen, die Infineon Anfang des Jahres vorgestellt hat.

„Wir sind stolz darauf, dass sich durch unsere VPD-Module TDM2354xT und TDM2354xD leistungsstarke KI-Rechenzentren realisieren lassen. Diese Bauteile maximieren die Systemleistung mit der für Infineon typischen Qualität und Robustheit und optimieren so die Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren“, sagt Rakesh Renganathan, Vice President Power ICs bei Infineon Technologies. „Unsere Leistungsbauteile und Gehäusetechnologien in Kombination mit unserer umfassenden Systemkompetenz ermöglichen leistungsstarkes und umweltfreundliches Computing – ganz im Rahmen unserer Mission, die Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben.“

Die Module TDM2354xD und TDM2354xT kombinieren die robuste OptiMOS™ 6-Trench-Technologie von Infineon, ein Chip-Embedded-Gehäuse, das zu einer verbesserten Leistungsdichte durch erhöhte elektrische und thermische Effizienz führt, und eine neue Induktivitätstechnologie, die ein niedrigeres Profil und damit eine echte vertikale Leistungsabgabe ermöglicht. Dadurch setzen die Module neue Akzente in Bezug auf Leistungsdichte und Qualität, um die Rechenleistung und Effizienz von KI-Rechenzentren zu maximieren. Die TDM2354xT-Module unterstützen bis zu 160 A und sind die branchenweit ersten Spannungsregler-Module mit Trans-Induktivität (TLVR) in einem kleinen Formfaktor von 8 x 8 mm². In Kombination mit den XDP™-Controllern von Infineon bieten sie eine äußerst schnelle Einschwingverhalten und minimieren die Ausgangskapazität auf der Platine um bis zu 50 Prozent, wodurch die Leistungsdichte des Systems weiter erhöht wird.

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202410-004d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

Die neuen Module werden am 17. Oktober auf dem globalen Technologieforum OktoberTech™ 2024 von Infineon im Silicon Valley vorgestellt. Zudem werden sie auf der electronica 2024 vom 12. bis 15. November in München zu sehen sein (Halle C3, Stand 502).

Verfügbarkeit
Muster der OptiMOS zweiphasigen Leistungsmodule TDM2354xD und TDM2354xT sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/aipowermodules.

Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse
Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202410-004d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com